

半導体ウエハ面内膜厚分布の評価



目指したもの

高密度局所プラズマ技術を用いて従来のCMPでは到達困難なレベルで膜厚の均一化が可能なウエハ加工技術を実現したい。

課題

- ウエハ上薄膜の面内膜厚分布の高精度計測

大阪技術研の支援内容

- 分光エリプソメータによる厚み分布計測
- 測定データの解析についての技術支援

● 支援メニュー

技術相談

装置使用

企業名	株式会社ジェイテックコーポレーション
所在地	大阪府茨木市彩都やまぶき2-5-38
URL	https://www.j-tec.co.jp/
事業内容	放射光施設用X線ミラーの設計製作及び販売 各種自動化システムの開発設計製作及び販売 各種材質の表面加工における開発製造及び販売

令和5年度（2023）企業支援成果事例集から一部抜粋